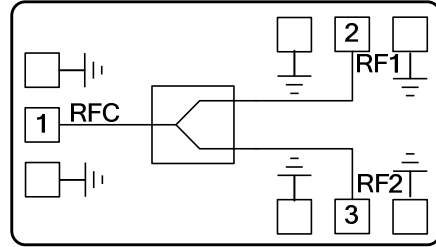




主要特点

- 频率范围: 15 - 50 GHz
- 插入损耗: 0.8 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: $1.5 \times 1 \times 0.1 \text{ mm}^3$

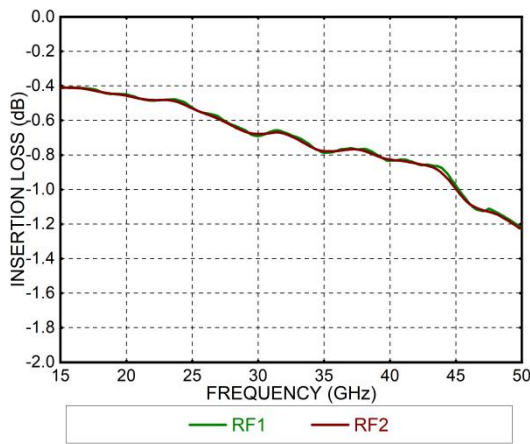
功能框图



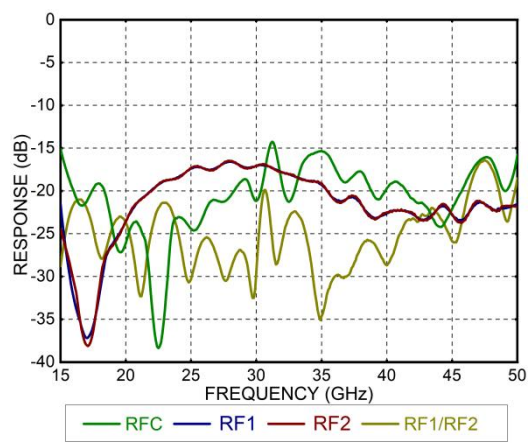
性能指标 ($T_A = +25 \text{ }^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0 \text{ dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	15 - 50			GHz
插入损耗		0.8		dB
平坦度		± 0.4		dB
隔离度		25		dB
回波损耗		20		dB

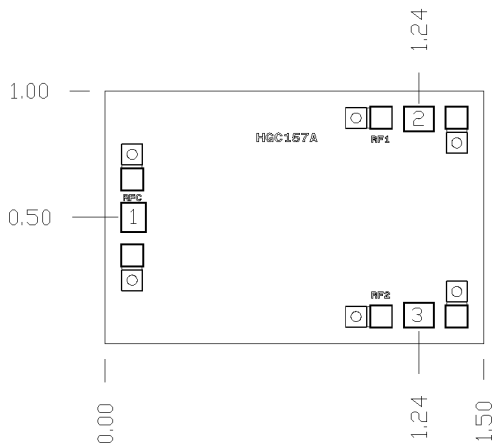
插入损耗



隔离度与回波损耗



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是射频公共端
2, 3	RF1, RF2	该系列焊盘射频支路端



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120*100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：
0.5+1.6 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+35 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$